

# 最高投标限价公布函

工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程

最高投标限价(元)：193,554,173.96

其中建安工程费最高投标限价(元)：193,554,173.96

分部分项工程费(元)：139,688,657.27

措施项目费(元)：17,439,268.42

其中安全生产措施费(元)：4,519,271.28

其他项目费(元)：20,444,710.97

其中暂列金额(元)：17,935,843.28

税金(元)：15,981,537.30

对公开招标工程，投标人须按照公布的安全生产措施费、暂估价、暂列金额报价。

序号	名称	单位	最高投标限价	分部分项工程费	安全生产措施费	暂估价	暂列金
1	建筑工程	元	139,688,657.27	139,688,657.27	4,519,271.28	/	17,935,843.28

招标单位 (盖章)

年 月 日